

平成21年3月期 第3四半期決算短信

平成21年1月29日

上場会社名 インターニクス株式会社
 コード番号 2657 URL <http://www.internix.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長兼COO (氏名) 田中 信也
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員財務経理本部長 (氏名) 加藤 孝雄
 四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

上場取引所 東

TEL 03-5322-1708

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第3四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第3四半期	16,006	—	99	—	79	—	△365	—
20年3月期第3四半期	19,541	△20.5	438	△55.1	402	△60.9	210	△67.0

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第3四半期	△37.71	—
20年3月期第3四半期	21.27	21.25

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
21年3月期第3四半期	14,875	10,292	10,292	69.2	69.2	1,062.72
20年3月期	16,081	10,977	10,977	68.3	68.3	1,133.48

(参考) 自己資本 21年3月期第3四半期 10,292百万円 20年3月期 10,977百万円

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年3月期	—	—	—	20.00	20.00
21年3月期	—	—	—	—	—
21年3月期(予想)	—	—	—	20.00	20.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	19,780	△21.8	△100	—	△130	—	△520	—	△53.69

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの
- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
- ② ①以外の変更 無
- 〔注〕詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。〕

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期第3四半期 9,903,800株 20年3月期 9,903,800株
- ② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 218,945株 20年3月期 218,944株
- ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年3月期第3四半期 9,684,856株 20年3月期第3四半期 9,873,766株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・平成20年5月13日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。

・業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と異なる場合があります。なお、予想数値に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融危機の影響が日本の実体経済にも波及し、かつて経験したことのない厳しい局面を迎えております。特に金融危機が深刻化した10月以降、景気は急速に冷え込んでおり、極めて厳しい状況下で推移いたしました。

当企業集団を取り巻く事業環境は、世界経済の急減速で需要が失速する中で、これと連動して、半導体市況も悪化の一途を辿っております。この景気後退の影響を強く受けて、クリスマス・年末商戦を控えた年間最大の需要期も、例年に比べ落ち込むなどの結果、顧客先においては、在庫調整、生産調整が急激に加速され、引き続き厳しい対応を余儀なくされました。

このような環境の中で、主力の半導体素子等販売事業において、既存市場の深耕を図るための拡販活動が効を奏し、一部の特定市場向け商品については堅実な伸びを記録することができました。また、新規に獲得した仕入先の商品については、早期の売上げに結び付けるべく、積極的な営業活動を展開し、各顧客先からは相応の評価を得、確かな手ごたえを感じております。しかしながら、事業環境の急変に伴い、顧客先における設備投資の抑制や在庫調整、生産調整が一段と加速し、半導体需要の減速感は一気に広まってまいりました。この結果、全体としては低調に推移し、売上高は、計画に対し未達成に終わりました。

利益面については、主力の半導体素子等販売事業において、利益率の比較的高い商品の売上げ比率が高まり、売上総利益率は計画を上回る水準で推移したものの、売上げの減少が大きく影響し、更には、半導体素子等検査事業で計上した赤字も加わって、営業利益及び経常利益ともに、計画に対し大幅な減益となりました。また、四半期純利益については、第2四半期において同検査事業に係る固定資産の減損処理を行い、これに伴い、減損損失3億4千2百万円を特別損失として計上したため、赤字計上となっております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が160億6百万円（前年同期比18.1%減）、営業利益が9千9百万円（前年同期比77.3%減）、経常利益が7千9百万円（前年同期比80.2%減）、四半期純損失が3億6千5百万円（前年同期は、2億1千万円の四半期純利益）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（半導体素子等販売事業）

IC・半導体においては、半導体製造装置、自動車製造設備を含む産業機器をはじめとする、幅広い分野で需要の不振が深刻化しております。その中であって、大型の薄型テレビやカーナビゲーション、防犯カメラ、業務用プロジェクタ、セットトップボックス向けは、引き続き、売上げ計上に一定の貢献をいたしました。しかしながら、国内市場の縮小による在庫調整、生産調整による半導体需要の減退が予想以上に深刻なだけに、厳しい対応を迫られております。その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は137億8千3百万円（前年同期比17.1%減）となりました。

電子部品においては、地震関連機器や官公庁向けリチウム電池は着実な伸びを維持したほか、業務用機器向けコネクタ及び液晶パネル用バックライトモジュールも、比較的堅調に推移いたしました。その一方で、前年同期の売上げに貢献した携帯電話向けモジュールビジネスが消滅し、加えて、最終製品の市場縮小により計測器向けの需要が低迷したほか、航空機内用エンターテイメント設備向け電源も計画を下回りました。その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は11億8千2百万円（前年同期比23.1%減）となりました。

電子機器においては、半導体製造装置を中心とする設備投資にブレーキがかかり、一般産業機器市場の在庫調整や受注の減少、ボード製品ビジネスの縮小などの下振れ要因により売上げが伸び悩み、苦戦を強いられました。その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は6億9千8百万円（前年同期比27.1%減）となりました。

この結果、半導体素子等販売事業における当第3四半期連結累計期間の売上高は156億6千5百万円（前年同期比18.1%減）、営業利益は1億4千5百万円（前年同期比69.6%減）となりました。

（半導体素子等検査事業）

半導体素子等検査事業においては、事業環境の大幅な下落に伴い、顧客先における生産計画の見直しが続ぎ、需要の急減による検査受託数量の大幅な減少や値下げ圧力が、なお一層強まっております。こうした環境のもと、業務の効率化や生産性の向上などの体質改善を推し進め、利益の確保に努めてまいりましたが、売上げ、利益ともに、厳しい状況下で推移いたしました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は3億4千1百万円（前年同期比17.8%減）、営業損失は4千6百万円（前年同期は、4千1百万円の営業損失）となりました。

なお、上記の前年同期比(増減率)につきましては、参考として記載しているものであります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び資本の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は148億7千5百万円であり、前連結会計年度末に比べ12億5百万円減少しました。このうち、流動資産は7億1千3百万円減少の125億6千8百万円、固定資産は4億9千1百万円減少の23億7百万円でした。流動資産の減少は主として、売掛金の減少によるもので、固定資産の減少は主として、有形固定資産において減損処理したことによります。

総負債は45億8千3百万円であり、前連結会計年度末に比べ5億2千万円減少しました。総負債の減少は主として、借入金の返済により減少したことと、買掛金の減少によるものであります。

純資産は、102億9千2百万円であり、前連結会計年度末に比べ6億8千5百万円減少しました。純資産の減少は主として、利益剰余金の減少によるものであります。

これにより、自己資本比率は69.2%と、前連結会計年度末に比べ0.9ポイント微増しました。

(2) キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第3四半期連結累計期間は11億4千4百万円であります。

これは主として、売上債権が15億3千万円の減少、たな卸資産が3億4千9百万円の増加、仕入債務が2億5千3百万円の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、当第3四半期連結累計期間は△2億6千4百万円でありません。

これは主として、貸付けによる支出1億2千1百万円、投資有価証券の取得による支出8千3百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、当第3四半期連結累計期間は△4億1百万円であります。

これは主として、短期借入金（純額）4億8百万円の返済によるものであります。

これにより、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、現金及び現金同等物に係る換算差額△4千1百万円を加味し、前連結会計年度末から、4億3千6百万円増加し、30億4千5百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当企業集団を取り巻く環境については、米国発の金融危機が世界全体の实体经济を冷え込ませており、この世界同時不況の影響が企業業績に及び始め、月を追うごとに悪化の様相を呈しております。半導体市況も、クリスマス・年末商戦が弱含みで推移し、需給が緩和する中で、世界景気の減速が追い打ちをかけたため、電子機器の需要減速に加え、各企業とも、かつてない危機感を募らせ、在庫の圧縮を急速に進めており、未曾有の不況に入ったともいわれております。今後の見通しについては、原油価格の下落など明るい材料もあるものの、景気回復の展望は未だ開けず、加えて、半導体市況も低迷の長期化が否めないため、極めて厳しい対応を余儀なくされるものと思われるため、平成20年10月30日付で発表いたしました平成21年3月期の業績予想を次のとおり下方修正いたします。

通期の連結業績といたしましては、売上高197億8千万円（前期比21.8%減）、営業損失1億円、経常損失1億3千万円、当期純損失5億2千万円を予定しております。

また、平成20年9月30日付で発表いたしました、株式会社ハイレルとの基本合意に基づき、両社において、同社の完全子会社化に向けて友好的に交渉等を進めてまいりましたが、米国発の金融危機が世界の实体经济に及ぼした影響は予想以上に深刻であり、このような中で、同社の企業価値の評価等を行い、結論を出すことは適切でないと判断するに至りました。ついては、平成20年12月26日付をもって、両社を取り巻く事業環境の推移を見守ったうえで、改めて交渉に入ることとし、その際には、業務提携などの幾つかの選択肢も視野に入れながら、両社において、友好的に検討、交渉を進めていくことで合意いたしました。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益がそれぞれ11,935千円減少し、税金等調整前四半期純損失が11,935千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,845,520	1,608,791
受取手形及び売掛金	4,598,466	6,153,342
有価証券	1,200,000	1,000,000
商品	3,302,441	2,940,065
製品	7,666	6,338
原材料	29,989	36,720
仕掛品	30,037	40,095
貯蔵品	5,719	5,887
未収入金	1,200,347	1,279,746
その他	450,133	322,325
貸倒引当金	△101,770	△110,774
流動資産合計	12,568,550	13,282,539
固定資産		
有形固定資産	1,005,247	1,382,296
無形固定資産	122,962	158,619
投資その他の資産		
その他	1,226,308	1,283,536
貸倒引当金	△47,508	△25,704
投資その他の資産合計	1,178,799	1,257,832
固定資産合計	2,307,009	2,798,748
資産合計	14,875,560	16,081,287

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,472,622	1,758,987
短期借入金	891,030	1,300,000
1年内返済予定の長期借入金	200,000	100,000
1年内償還予定の社債	500,000	500,000
未払法人税等	322	1,065
役員賞与引当金	2,000	5,500
その他	502,994	559,521
流動負債合計	3,568,970	4,225,073
固定負債		
長期借入金	300,000	200,000
退職給付引当金	510,650	479,879
役員退職慰労引当金	168,183	164,217
その他	35,503	34,526
固定負債合計	1,014,338	878,624
負債合計	4,583,308	5,103,698
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,157,792	1,157,792
資本剰余金	1,340,172	1,340,172
利益剰余金	7,643,348	8,202,290
自己株式	△126,938	△126,937
株主資本合計	10,014,375	10,573,318
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	327,663	434,752
為替換算調整勘定	△49,787	△30,481
評価・換算差額等合計	277,876	404,271
純資産合計	10,292,251	10,977,589
負債純資産合計	14,875,560	16,081,287

(2) 四半期連結損益計算書
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)
売上高	16,006,608
売上原価	13,105,391
売上総利益	2,901,216
販売費及び一般管理費	
従業員給料及び手当	1,021,858
従業員賞与	263,750
役員賞与引当金繰入額	2,000
退職給付引当金繰入額	57,520
役員退職慰労引当金繰入額	3,966
貸倒引当金繰入額	23,000
その他	1,429,886
販売費及び一般管理費合計	2,801,982
営業利益	99,234
営業外収益	
受取利息	11,063
受取配当金	43,875
その他	13,772
営業外収益合計	68,712
営業外費用	
支払利息	17,080
手形売却損	6,745
支払補償費	9,119
支払手数料	9,314
為替差損	34,283
その他	11,725
営業外費用合計	88,269
経常利益	79,677
特別利益	
貸倒引当金戻入額	5,458
投資有価証券売却益	14,903
特別利益合計	20,362
特別損失	
減損損失	342,000
固定資産売却損	2,894
固定資産除却損	395
投資有価証券評価損	46,239
その他	493
特別損失合計	392,023
税金等調整前四半期純損失(△)	△291,983
法人税、住民税及び事業税	69,332
法人税等調整額	3,928
法人税等合計	73,261
四半期純損失(△)	△365,244

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純損失 (△)	△291,983
減価償却費	126,464
減損損失	342,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	12,799
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△3,500
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	30,770
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	3,966
受取利息及び受取配当金	△54,939
支払利息	17,080
為替差損益 (△は益)	23,448
投資有価証券売却損益 (△は益)	△14,409
投資有価証券評価損益 (△は益)	46,239
有形固定資産売却損益 (△は益)	2,894
売上債権の増減額 (△は増加)	1,530,453
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△349,906
未収入金の増減額 (△は増加)	119,993
仕入債務の増減額 (△は減少)	△253,947
その他	△127,707
小計	1,159,715
利息及び配当金の受取額	53,913
利息の支払額	△18,164
法人税等の支払額	△106,125
法人税等の還付額	55,087
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,144,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△44,560
投資有価証券の取得による支出	△83,344
投資有価証券の売却による収入	21,156
貸付けによる支出	△121,966
その他	△35,355
投資活動によるキャッシュ・フロー	△264,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△408,970
長期借入れによる収入	200,000
配当金の支払額	△192,775
財務活動によるキャッシュ・フロー	△401,745
現金及び現金同等物に係る換算差額	△41,880
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	436,729
現金及び現金同等物の期首残高	2,608,791
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,045,520

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

当第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)

	半導体素子等 販売事業 (千円)	半導体素子等 検査事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	15,665,169	341,439	16,006,608	—	16,006,608
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	4,484	4,484	(4,484)	—
計	15,665,169	345,923	16,011,092	(4,484)	16,006,608
営業利益又は営業損失(△)	145,833	△46,599	99,234	—	99,234

(注) 1 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。

2 各事業区分の主な内容

(1) 半導体素子等販売事業…アナログIC、メモリIC、リニアIC、特定用途IC、カスタムIC、A/Dコンバータ、ICソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示器製品、パソコン本体及び周辺機器

(2) 半導体素子等検査事業…各種IC検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業

3 会計処理の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。これにより、半導体素子等販売事業の営業利益が11,935千円減少しております。

(所在地別セグメント情報)

当第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(海外売上高)

当第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)

	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高(千円)	2,184,236	28,147	2,212,383
II 連結売上高(千円)	—	—	16,006,608
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	13.6	0.2	13.8

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…中国、タイ、シンガポール、マレーシア

(2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

「参考資料」

前年同四半期に係る連結財務諸表

(1) 四半期連結損益計算書

	前第3四半期連結累計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	
区分	金額(千円)	
I 売上高		19,541,566
II 売上原価		16,305,689
売上総利益		3,235,877
III 販売費及び一般管理費		2,797,852
営業利益		438,025
IV 営業外収益		42,142
V 営業外費用		78,080
経常利益		402,087
VI 特別利益		2,356
VII 特別損失		6,478
税金等調整前四半期純利益		397,965
法人税、住民税及び事業税	140,471	
法人税等調整額	47,473	187,945
四半期純利益		210,020

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)
区分	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	397,965
減価償却費	156,102
売上債権の増減額(△:増加)	504,233
たな卸資産の増減額(△:増加)	161,331
仕入債務の増減額(△:減少)	△365,474
その他	37,058
小計	891,215
利息及び配当金の受取額	35,852
利息の支払額	△17,762
法人税等の支払額	△502,368
営業活動によるキャッシュ・フロー	406,937
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△112,586
投資有価証券の取得による支出	△47,173
投資有価証券の売却による収入	2,222
その他	2,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△155,347
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額(△:純減少)	500,000
長期借入れによる収入	100,000
長期借入金の返済による支出	△719,467
自己株式の取得による支出	△72,506
配当金の支払額	△176,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△368,938
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	8,087
V 現金及び現金同等物の増減額(△:減少)	△109,259
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,469,161
VII 現金及び現金同等物の四半期末残高	2,359,901

(3) セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

科目	半導体素子等 販売事業 (千円)	半導体素子等 検査事業 (千円)	計 (千円)	消去 又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	19,126,328	415,238	19,541,566	—	19,541,566
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	2,657	2,657	(2,657)	—
計	19,126,328	417,896	19,544,224	(2,657)	19,541,566
営業費用	18,647,090	459,108	19,106,198	(2,657)	19,103,541
営業利益又は営業損失(△)	479,237	△41,212	438,025	—	438,025

(注) 1 事業区分は、商品の種類、性質と事業展開の共通性を基準として区分しております。

2 各事業区分の主な内容

- (1) 半導体素子等販売事業…アナログIC、メモリIC、リニアIC、特定用途IC、カスタムIC、A/Dコンバータ、ICソケット、リチウム電池、システムボード製品、ネットワーク製品、表示器製品、パソコン周辺機器
- (2) 半導体素子等検査事業…各種IC検査、バーンイン検査、ソケット検査、テーピング作業

(所在地別セグメント情報)

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の売上高の割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(海外売上高)

前第3四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

	アジア	その他の地域	計
I 海外売上高(千円)	2,726,933	110,431	2,837,364
II 連結売上高(千円)	—	—	19,541,566
III 連結売上高に占める海外 売上高の割合(%)	13.9	0.6	14.5

(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

- (1) アジア…中国、タイ、シンガポール、マレーシア
- (2) その他の地域…アメリカ、ヨーロッパ

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

6. その他の情報

(生産、受注及び販売の状況)

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称		前第3四半期連結累計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)
半導体素子等 販売事業	IC・半導体	—	—	—	—
	電子部品	—	—	—	—
	電子機器	181,336	100.0	144,509	100.0
合計		181,336	100.0	144,509	100.0
半導体素子等検査事業		—	—	—	—
合計		181,336	100.0	144,509	100.0

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 金額は製造原価によっております。

(2) 受注状況

事業の種類別セグメントの名称		前第3四半期連結累計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	
		受注高 (千円)	受注残高 (千円)	受注高 (千円)	受注残高 (千円)
半導体素子等 販売事業	IC・半導体	16,383,800	3,185,014	12,882,275	2,204,668
	電子部品	1,179,578	480,209	949,889	297,062
	電子機器	1,026,892	287,968	826,084	336,329
合計		18,590,272	3,953,191	14,658,248	2,838,060
半導体素子等検査事業		415,238	—	341,439	—
合計		19,005,510	3,953,191	14,999,687	2,838,060

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2 受注高には、受注取消、変更、為替レートの変動による調整額を含んでおります。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称		前第3四半期連結累計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)
半導体素子等 販売事業	IC・半導体	16,630,076	85.1	13,783,550	86.1
	電子部品	1,537,392	7.9	1,182,916	7.4
	電子機器	958,859	4.9	698,701	4.4
合計		19,126,328	97.9	15,665,169	97.9
半導体素子等検査事業		415,238	2.1	341,439	2.1
合計		19,541,566	100.0	16,006,608	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。